

2024 第三届全国电子材料与器件大会

National Conference on Electronic Materials and Devices

邀请函

尊敬的_____先生/女士：您好！

热忱欢迎您参加“2024 第三届全国电子材料与器件大会”。

会议旨在针对电子材料与器件领域及相关交叉学科的发展重点、热点、前沿问题展开讨论，分享最新成果，从研究与应用视角探讨我国电子材料与器件基础研究思路、面临的机遇、挑战与未来趋势，积极推进技术进步和工程化协同，把握科研和产业的发展趋势，推动产学研合作与跨越发展。

在此，我们诚挚地邀请您出席，您的参与和帮助，是大会成功的重要保证。现将有关安排告知如下：

一、时间、地点：2024年10月25-28日 青岛市

二、会议官网：www.c-nmaterial.com.cn

三、组织机构

主办单位：中国电子节能技术协会新材料专业委员会、材料平台、先进电子材料与器件专家委员会

承办单位：北京中科智材新材料科技发展中心、北京高科前沿科技发展中心

三、会议内容（包括但不限于）

半导体、微电子与集成电路，电子元器件，光电子、光子材料与器件，磁性材料与器件，信息存储材料、器件和磁电子学，低维电子材料，能源与电子材料，电子材料与生物医学，电子材料与智能传感，电磁兼容与防护，其它等；

四、会议注册（食宿自理）

注册类型	6.30日前	现场	付款方式
普通代表	3000	3200	1、户名：北京高科前沿科技发展中心 账号：9550880223115100198 开户行：广发银行股份有限公司北京和平里支行
会员代表	2800	3000	
学生代表	1800	2000	2、户名：北京中科智材新材料科技发展中心 账号：0200250109200790477 开户行：中国工商银行股份有限公司北京复兴门支行
企业代表	3200	3500	
线上参会	1500/人		

现场收费说明：现场注册（缴费）代表，由“青岛市会务服务公司”收取会议费并开具发票

